卵日本国特許庁(IP)

の特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-207799

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和63年(1988) 8月29日

B 64 G 1/50 F 25 D H 05 K 9/00 7/20 7615-3D -8113-3L -7373-5F

未請求 審査請求 発明の数 1 (全3百)

図発明の名称

入工衛星の熱制御装置

昭62-37521 印特

願 昭62(1987)2月20日 四出

砂発 明 者

岡 本 査

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

頣 仍出 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 弁理士 本庄

明

1.発明の名称

人工衛星の熱制御袋置

2.特許請求の氮囲

相転移を起こす遷移温度より高い温度範囲では 熱伝導率が高く、前記温度より低い温度範囲では 熱伝導率の低い相転移物質からなり、入工衛星の 搭載機器とヒートシンクとの間にそれらと接触し て配置したことを特徴とする人工衡星の熱制御袋 置.

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は人工衛星の搭載機器の熱制御装置に関 する.

(従来の技術およびその問題点)

人工衛星に搭載される機器は太陽熱や筐体内の 搭載機器からの発熱による高温状態あるいは宇宙 空間の極低温状態などに晒される。機器類には許 客温度範囲が設けられており、これら機器類はこ の温度範囲より高温または低温の温度領域では正 常に作動しないかまたは破損することがある。そ こで人工衛星には熱制御装置を装備して搭載機器 の温度制御を行う。熱制御装置としては放熱パネ ルなどのヒートシンクがよく用いられる。高眞空 の宇宙空間では空気の対流による冷却は行えない から、ヒートシンクは搭載機器に接触させて取り 付けられる。機器から発生した熱は接触面を伝っ てヒートシンクへ移動し、宇宙空間へ放散し機器 の温度が過度に上昇することが防止される。しか し、機器の発熱量が多く高温のときはもちろん発 熱量が少なくて低温であるときも、絶対零度に近 い低温の宇宙空間に晒されたヒートシンクと搭載 機器との間には大きな温度差がある。従って、搭 軟機器はその熱をヒートシンクに絶え間なく奪わ れて冷却される。このようにして失われる熱が搭 載複器自身の発熱や太陽熱などで補充される間、 搭載機器の温度は許容範囲内に留るが、熱の補給 が絶えると、機器の温度は許容範囲の下限を下回 ることがある。そこで、このような状態のときに 搭載機器を加熱するためにヒータが装備される。 ヒータにはサーモスタットのような付属部品が必 要である。ヒータの消費電力は大きく、その上ヒ ータとその付属部品を装備しただけ信頼性が低下 する。これらのことは、消費電力や信頼性の面で 散しい創約を受ける人工衛星とその搭載機器の設 計上の大きな障害になっている。

本発明の目的は、ヒータで熱量を補わなくても 搭載機器が過冷却されることのない、人工衝星の 熱制御装置を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の人工衛星の熱制御袋健は、相転移を起こす過移温度より高い温度範囲では熱伝導率が高く、前記温度より低い温度範囲では熱伝導率の低い相転移物質からなり、人工衛星の搭載機器とヒートシンクとの間にそれらと接触して配置したことを特徴とする。

(実施例)

ようにこの時帯載機器3とヒートシンク2との間にはまだ大きな温度差があるが、熱伝導率の低くなった熱制御装置1が熱の移動を運断するから搭載機器3は過冷却されることなく、許容温度範囲内に保たれる。

第1図に示した実施例および搭載機器3とヒートシンク2とを接触して配置する従来例における、搭載機器の発熱量Qと温度Tのグラフを第2図に示す。このグラフにおいて、T。はヒートシンクの温度、Teは二酸化パナジウムが相転移を起こす遷移温度、またT。。、Taraはそれぞれ搭載機器3の許容温度範囲の上限と下限であり、Q。。、Q。。は搭載機器3の発熱量のそれぞれ上限と下限である。2物体間の熱の移動量はそれら物体の温度差および2物体間の熱伝導率に比例する。

従って、従来例の場合搭載機器3とヒートシンク2の間の熱伝導率をKとすると、

$$Q = K (T - T_i)$$
 (1)

となる。(1)式を変形すると

第1 図に本発明の一実施例を示す。

本実施例では相転移物質として二酸化パナジウ ムを用い、これを層状に成形して熱制御装置1と した。二酸化パナジウムは過移温度で相転移を起 こし、遷移温度より高温域では金属的性質を示し て熱伝導率が高くなり、遷移温度より低温域では 絶縁体に近い性質を示して熱伝導率が低くなる。 搭載機器3の発熱量が多い間は、その熱によって 温められて、熱制御装置1の二酸化パナジウム層 は避移温度より高温に保たれる。この温度域では 二酸化パナジウムの熱伝導率は高いから搭載機器 3からの発熱は高い効率でヒートシンク2に導か れ宇宙空間に放散されて、搭載機器3の温度は過 度に上昇することなく許容温度範囲内に保たれ る。搭載機器3が例えば休止状態または間歇的な 作動状態に移り発熱量が減ると、搭載機器3から の熱の補給が不充分になるからヒートシンク2に 冷却されて熱制御装置1の温度は下降する。 遷移 温度まで下降すると二酸化パナジウムは相転移を 起こして、その熱伝導率は低くなる。上に記した

T=1/K・Q+T。 (2)
となり、破線のようなグラフになる。このグラフ
が示すように、従来例では搭載機器3の温度では
発熱量に比例して変化するから、発熱量 Q1以下
では許容温度範囲の下限 Talaより低くなる。
従って、搭載機器3を加熱して許容温度範囲内に

次に、本実施例の場合、Ku, Ksを二酸化パナ ジウムの遷移温度Tcよりそれぞれ高温域と低温 域での熱伝導率とすると、(2)式は

保つためのヒータが必要になる。

 $T > T_c o \ge b t$, $T = 1 / K_* \cdot Q + T_c$

(3)となり、

(4)となる。

K m は充分大きいから、搭載機器 3 とヒートシンク 2 の間の熱の移動を妨げない。従ってT> T c の範囲では、搭載機器 3 とヒートシンク 2 の間の 熱伝導率は、二酸化バナジウムの層が介在しない 場合の熱伝導率 K に実質的に等しいと考えてよい。よって、Aで示した(3)式のグラフは破線

特開昭63-207799(3)

のグラフと一致し、搭較機器3は従来例と間様に、効果的に冷却される。また、T<Tεの範囲において、Kiは小さく従ってグラフの勾配は(2)式より大きく、Y軸との交点はT・でなってある。であり、大きなが、交換量がQaieのグラフが示すように、発熱量がQaieの搭載機器3の温度は、破線で示した従客での指載機器3の温度は、でである。このように、搭載機器3の温度はアコンとのである。このように、搭載機器3の温度はアコンとのである。

(発明の効果)

このように、本発明の熱解御装置は人工衡星の 搭載機器を、それが高温のときは冷却し、それが 低温のときは保温して、許容温度範囲内に係つ。 従ってヒータは不要であり、電力の大きな節約と 信頼性の向上に寄与する。

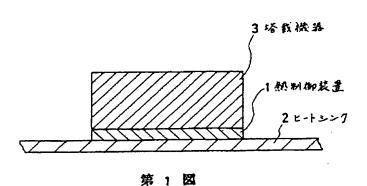
4. 図面の簡単な説明

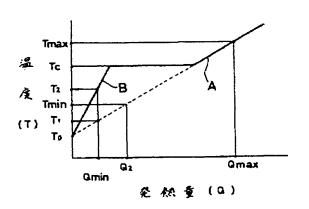
第1図は本発明の一使用例の断面図である。第

2 図は第1 図に示した実施例および従来例における搭載機器の発熱量と温度の関係を示したグラフである。

1…熱制御装置、2…ヒートシンク、3…搭載機器。

代理人 弁理士 本庄伸介





第 2 図